



## Конференция «Системы-в-корпусе: проектирование и производство»

28 марта 2019 года, Москва

**Участники конференции:** разработчики микросхем, систем-на-кристалле, разработчики электронного оборудования, технологи и директора производств, поставщики технологического оборудования, САПР, производственных услуг.

- ✓ 10.00 - начало конференции
- ✓ 11.30 - 12.00 кофе-брейк
- ✓ 13.30 - 14.30 обед
- ✓ 16.00 – 16.30 кофе-брейк
- ✓ 18.00 окончание конференции

### Основные вопросы конференции:

- Развитие технологий и рынка систем-в-корпусе
- Проектирование систем-в-корпусе
- Производство и тестирование систем-в-корпусе
- Стандартизация, стратегическое планирование, подготовка кадров

### Список докладов:

- 1 Перспективы использования технологии SiP в России.  
*Сергей Беляков, руководитель отдела маркетинга и продвижения, GS Nanotech*
- 2 Перспективные конструктивно-технологические решения для производства систем в корпусе.  
*Сергей Тимошенко, доктор технических наук, профессор, директор Института нано- и микросистемной техники, НИУ МИЭТ*  
*Денис Вертянов, руководитель Учебно-научного центра Проектирования Mentor Graphics, Институт нано- и микросистемной техники, МИЭТ*
- 3 Проектирование и разработка систем-в-корпусе. Опыт GS Nanotech.  
*Михаил Чувствин, начальник опытно-конструкторского отдела, GS Nanotech*
- 4 Разработка многокристальных 3D сборок в корпусе.  
*Виктор Ваньков, начальник отдела разработки систем в корпусе, АО "ПКК Миландр"*
- 5 Технология SiP. Преимущества.  
*Максим Савицкий, ведущий инженер-конструктор многокристальных модулей, GS Nanotech*

- 6 Платформа корпусирования интегральных схем: визуализация, оптимизация, ко-дизайн, трассировка.  
*Кирилл Никеев, ведущий технический консультант, PCB, Mentor Graphics*
- 7 Маршрут проектирования и верификации топологии аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем и МЭМС Tanner AMS IC.  
*Иван Селиванов, ведущий специалист, АО МЕГРАТЕК*
- 8 Проектирование и моделирование систем-в-корпусе с применением программных продуктов Cadence.  
*Алексей Решетников, генеральный директор, Engineering Solutions, Ltd*
- 9 Особенности проектирования современных корпусов, трёхмерных микросборок и инерциальных микросистем средствами маршрута Xpedition Enterprise.  
*Игорь Беляков, аспирант, Институт нано- и микросистемной техники, НИУ МИЭТ*
- 10 Особенности производства систем в корпусе на основе LTCC.  
*Сергей Чигиринский, технический директор, к.ф.-м.н., ООО "АК Микротех"*
- 11 Цифровой изолятор в корпусе, выполненный на основе керамики низкотемпературного обжига (LTCC).  
*Владимир Бутузов, к.т.н., ведущий разработчик ИС и СнК, ООО "ОКБ Пятое Поколение"*  
*Владимир Косевской, директор по производству, АО "НПЦ СпецЭлектронСистемы"*
- 12 Системы-в-корпусе: опыт разработки и производства СВЧ-устройств в микрокорпусах.  
*Сергей Доровских, главный технолог, АО "Микроволновые системы"*
- 13 Производство систем-в-корпусе – от сборки прототипов и единичных изделий к массовому производству.  
*Константин Белов, главный технолог, GS Nanotech*
- 14 Особенности тестирования систем-в-корпусе: опыт, практика, рекомендации.  
*Андрей Скворцов, инженер, Keysight Technologies*
- 15 Тестирование систем в корпусе при производстве.  
*Алексей Болебрух, ведущий инженер-тестировщик, GS Nanotech*
- 16 Особенности электрического тестирования систем-в-корпусе. Реализованные проекты в России.  
*Игорь Смирнов, коммерческий директор, ООО "Остек-Электро"*